

## 中期経営計画 (2025-2027年度)

2025/05/09

株式会社東京精密

代表取締役会長CEO 吉田 均  
代表取締役社長COO 木村 龍一  
代表取締役副社長 CFO 川村 浩一

- ・ **将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ・ **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

- 当社は、2027年度を終了年度とする3か年の中期経営計画を策定いたしました。
- 本日は、この中期経営計画について説明いたします。

## アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

- 本日説明する内容は2ページの通りです。
- まず、前回、2022年度から2024年度までの中期経営計画の振り返りを説明し、その後、長期視点として、当社のパーパス、長期ビジョンを説明いたします。
- 次に、今回の中期経営計画の位置づけ・基本方針・定量目標、達成に向けた事業機会、ならびに、計画の土台となるサステナビリティに関する取り組みを紹介いたします。

## アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

- まず、前回の中期経営計画の振り返りです。

## 前中期経営計画 振り返り- 定量目標

民生アプリケーション需要が想定以上に停滞、売上高・営業利益(率)は定量目標に未達

ROEは3年平均で目標の15%を達成

売上高・純利益は2024年度、営業利益は2022年度に既往ピークを更新

	2021年度 実績 <sup>(*)</sup>	2022-2024年度 中期経営計画 定量目標	2022年度 実績	2023年度 実績	2024年度 実績
売上高	1,307億円 半導体1,011億円 計測296億円	1,700億円 半導体1,320億円 計測380億円	1,468億円 半導体1,124億円 計測344億円	1,346億円 半導体1,001億円 計測346億円	1,505億円 半導体1,135億円 計測371億円
営業利益	285億円 半導体247億円 計測36億円	375億円	345億円 半導体299億円 計測46億円	253億円 半導体199億円 計測54億円	297億円 半導体243億円 計測54億円
営業利益率	22% 半導体24% 計測12%	22%	23% 半導体27% 計測13%	19% 半導体20% 計測16%	20% 半導体21% 計測15%
ROE	17%	15%以上	3年平均 15% <sup>(**)</sup>		

### 総括

- 半導体売上高：  
民生需要の伸び悩みを主因に定量目標を下回ったが、生成AI(ロジック・HBM等)を含むHPC、中国需要などで、既往ピークを更新
- 計測売上高：  
ものづくり市場、NEV需要共に軟調ななか、成長業界への販売多角化や製品価格改定で増収、既往ピークを更新
- 営業利益：  
売上増加により2022年度に既往ピーク更新し利益率も目標達成したが、部材調達コストや経費の上昇による下押し圧力が高まる
- ROE：3年平均ROE15%を達成

(\*) 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、本資料に掲載の2021年度の数値は、期中平均レートを適及適用した数値を記載しております。

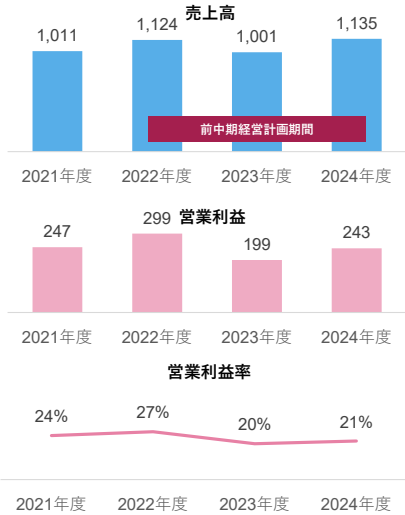
(\*\*) 3年平均ROE = 親株主に帰属する当期純利益(2022-2024年度単純平均) ÷ 自己資本(2021-2024年度単純平均) で算出

- 4ページは、前回の定量目標と、実績です。色付けしたものが、期間内のピーク数字です。
- 売上高について、半導体では、成長のけん引役としていた民生アプリケーション需要が想定以上に停滞したことを主因に定量目標を下回りましたが、生成AIに関連したロジックデバイスやHBMなどを含む、いわゆるHPC需要や中国需要がけん引し、2024年に既往ピークを更新しました。
- 計測では、ものづくり市場全般で、新規投資需要が伸び悩みましたが、販売の多角化などで、こちらも2024年度に既往ピークを更新しました。
- 営業利益、利益率は、2022年度に目標を達成しましたが、部材価格や人件費の上昇などが、利益成長を圧迫しました。
- ROEは、3年平均で目標の15%を達成しました。

## 前中期経営計画 振り返り - 半導体製造装置

2024年度に売上ピーク、2022年度に利益ピークを更新

半導体デバイスの高機能化や複雑化は一定の事業機会となったが、個数成長やSiC需要は限定的にとどまった

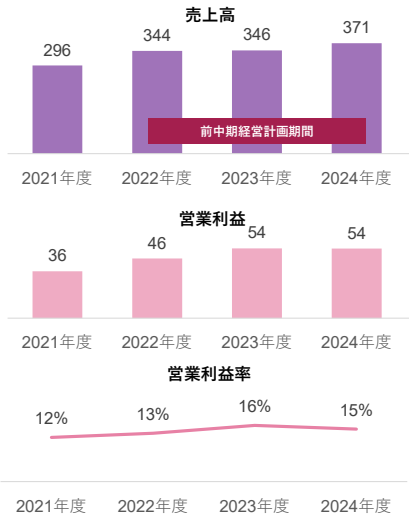


前提	当社の事業機会	振り返り
<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体デバイスの高機能・複雑化</li> <li>高信頼性デバイスの増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査の重要性が増す</li> <li>測定時間延伸</li> <li>測定条件の広がり</li> <li>積層・パッケージングの進化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査重要性が増加</li> <li>測定時間が延伸 (微細化, ビット成長, テスト数増)</li> <li>高精度温度制御が注目技術に</li> <li>AI中心にパッケージング需要が増加し、加工装置に恩恵</li> <li>検査需要も増加</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>安定した半導体個数成長 (大量生産・大量消費)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加工装置の需要増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>民生アプリケーション停滞 想定市場より弱い推移</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>カーボンニュートラルに向けた SiC/GaN パワー半導体の革新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市場そのものの拡大</li> <li>新たな加工プロセス構築</li> <li>信頼性重視の検査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一定の需要獲得も 2024年度以降は減速基調</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>デバイス検査・加工精度要求の高まり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社計測機器とのシナジー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>グローバ+光計測、ダイサ+光計測の新製品を展開</li> </ul>

- 5ページは半導体事業の振り返りです。
- 左側に、売上高、営業利益、利益率の推移、右側に、前回計画策定時の市場前提、当社の事業機会と、その振り返りを示しています。
- 最上段の、半導体の高機能化、下段の検査・加工精度の高まりは、当社によって一定の事業機会となりました。
- 一方で、中段の、半導体個数成長に伴う加工装置需要の高まりや、SiCなどパワー半導体の革新は、限定的な需要に留まりました。

## 前中期経営計画 振り返り – 計測機器

ものづくり市場の新規投資が限定的、かつNEVへの移行がスローダウンする中、対象市場の拡大、充放電試験システムの展開などを通じて3期連続増収



前提	当社の事業機会	振り返り
<ul style="list-style-type: none"> <li>● カーボンニュートラルに向けたNEV・再エネ市場拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NEV化による素材/部品の変化</li> <li>● 高精度測定需要の増加</li> <li>● NEVなどのバッテリー測定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NEVへの移行が想定より緩慢</li> <li>● 充放電試験システムの事業機会増</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ものづくり自動化の流れ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ロボットと測定機の組合せ</li> <li>● 高精度部品の全数測定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一定の需要獲得</li> <li>● 今後の市場拡大に期待</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非自動車分野のものづくり拡大 (半導体・航空宇宙・ロボット)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半導体向け (非接触)</li> <li>● 航空・宇宙基幹部品 (高精度)</li> <li>● 協働ロボット向け</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各分野で事業機会を獲得</li> <li>● 政府の補助金政策も後押し</li> </ul>

- 6ページは 計測事業の振り返りです。
- 計測市場では、NEVや再生エネルギー市場の早期拡大などを想定しておりました。
- 振り返ると、NEVへの移行は想定より緩慢ではあるものの、充放電試験システムの事業機会が増えたほか、モノづくりの自動化の流れを受けたオートメンション需要や非自動車分野の需要を多く獲得し、3期連続の増益を達成しました。

## 前中期経営計画 振り返り - 主な取り組み

概ね 計画通りの成果となり、次期中期経営計画の基盤を構築した

項目	取り組み内容	主な成果
研究開発投資	● 先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 試験研究費総額 279億円</li> <li>● 中期経営計画(2025-2027年度)の中核製品を開発・展開 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 高精度温度制御プローバ</li> <li>➢ ハイエンドグラインダ</li> <li>➢ 二次電池用充放電試験システム</li> </ul> </li> </ul>
生産キャパシティ拡充	● 飯能工場稼働	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設備投資総額 316億円</li> <li>● 半導体生産キャパシティ1,400億+α/年の水準を達成 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 飯能工場(埼玉県)稼働</li> <li>➢ 八王子工場リノベーション</li> </ul> </li> <li>● 名古屋工場 着工 (2025年7月竣工予定)</li> </ul>
環境投資	● 2030年CO2排出量 50%削減(2018年度比)に向け、必要な投資を検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主要工場でCO2フリー電力導入、効率化投資を実行</li> <li>● 既存工場<sup>(*)</sup>でのCO2排出量を 2018年度比 約40%削減</li> </ul>
投資評価指標	● 社内評価基準にROICを検討	● 2022年度より事業セグメント別ROIC評価を開始
アプリケーション強化	● 各国拠点におけるデモ設備強化	● 5拠点で設備新設または評価装置のラインナップ増強
非財務 (ESG取り組み強化)	● ESG各取り組み強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 人権活動・サプライチェーンCSR活動の強化</li> <li>● 人的資本への取り組み強化</li> <li>● ESGスコア上昇 (MSCI: BB → A、FTSE 3.1 → 3.57)<sup>(**)</sup></li> </ul>

(\*) 対象：東京精密単体の工場設備(2023年度竣工の飯能工場、2024年度移管の古殿工場を除く)

(\*\*) 2022年6月から2024年6月の変化

- 7ページは、主な取り組みとした項目に関する振り返りです。
- 研究開発面では、3年で279億円を投じ、次の中期経営計画の中核となる 高精度温度制御プローバ、ハイエンドグラインダ、二次電池用充放電試験システムなどの新製品を、開発・展開しました。
- 生産キャパシティ拡充の面では、3年で316億円を投じ、飯能工場を竣工、半導体の年間生産キャパシティを1400億円+αの水準に高めたほか、次に向けた名古屋工場の建設に着手しました。
- そのほか、環境投資、投資評価指標、アプリケーション強化、非財務の取り組みは、記載の通りです。

## アジェンダ

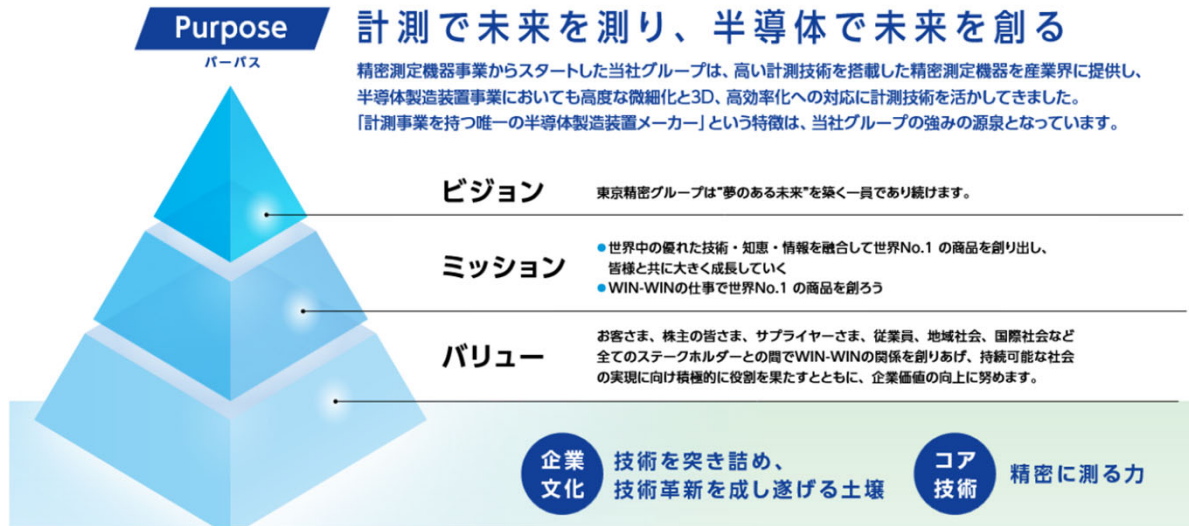
- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

- 次に、当社の存在意義、すなわちパーパスと長期ビジョンを説明します。
- この内容は、統合報告書にも記載しているものです。



## 東京精密のパーパス

創業時から受け継ぐ「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」を継承し  
世界中の技術・知恵・情報の融合で、「夢のある未来」の実現を目指す



- 9ページ、東京精密のパーパスは、「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」です。
- 1949年の創業以来、当社は高い計測技術を搭載した機器を産業界に提供し、これを半導体製造装置へも活かしてまいりました。
- 「計測事業を持つ唯一の半導体製造装置メーカー」という特徴は、当社の強みの源泉となっております。
- 「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」を継承し、世界中の技術・知恵・情報の融合で、「夢のある未来」の実現を目指す、これが当社の目指す姿です。

## 東京精密グループ長期ビジョン2050



- 10ページに、長期ビジョン2050を示しています。
- 当社は、不確実性が高い時代、事業環境の変化に合わせて変わり続けながら成長していくための「長期ビジョン」を策定しており、やるべき対応の洗い出しと、成長戦略を検討しています。
- 今回の中期経営計画は、このビジョンの中で、特に今後10年で獲得、または強化すべき項目を実現する、最初のフェーズと定義しています。

## アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- **中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標**
- 中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

- 次に今回の中期経営計画の位置づけ、基本方針、定量目標を説明します。

## 中期経営計画(2025-2027年度)の位置づけ

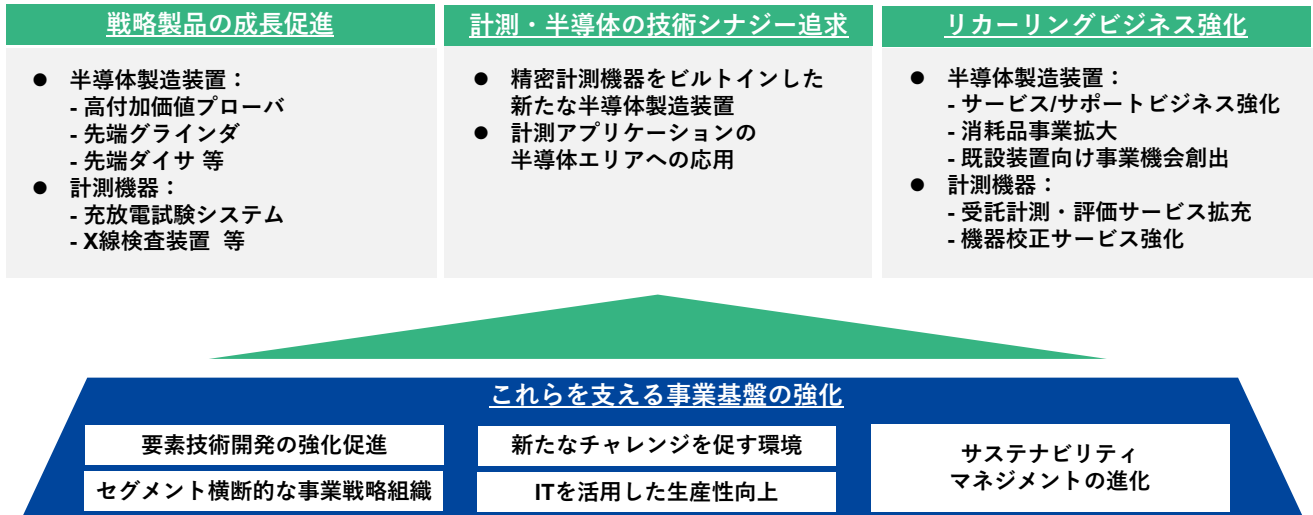
中期経営計画(2025-2027年度)では、「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」とを両立する



- 12ページは、今回の中期経営計画の位置づけを示しています。
- 当社は、10年後には、「当社の製品やサービスがなければモノを作れない、測れない」というポジションを確立したいと考えております。
- 前回の中期経営計画は、そのための布石でした。
- 今回の中期経営計画は、10年度に確立するポジション確立の足場固めと、インフラ作りを進める活動を強化するフェーズと位置づけており、同時に、期間の成長を実現させたいと考えています。

## 中期経営計画(2025-2027年度)の基本方針

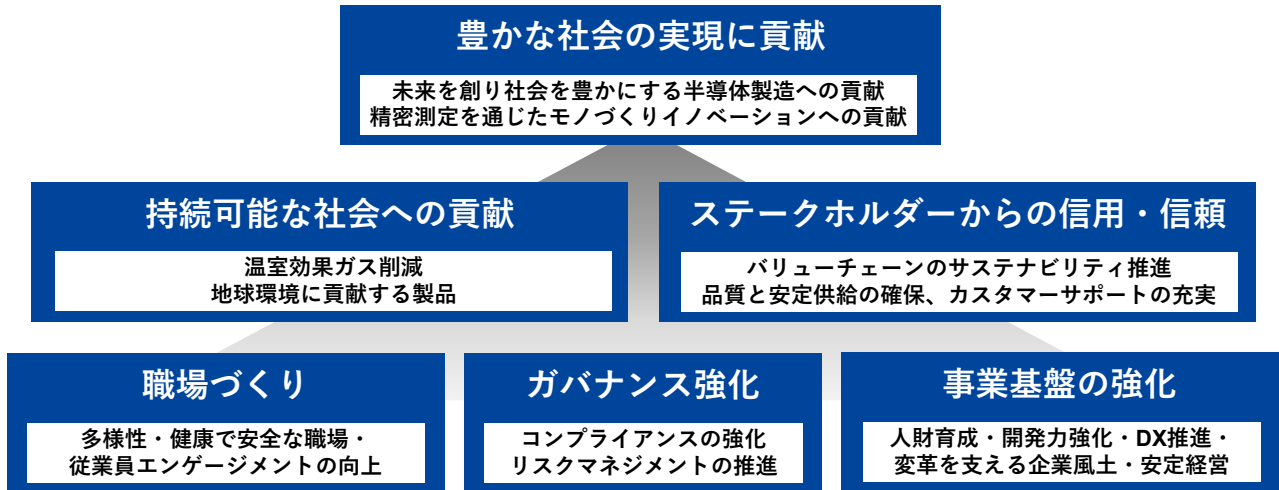
事業強化と事業基盤そのものの強化を両立させる



- 13ページは、中期経営計画の基本方針です。
- 大方針は、「戦略製品の成長促進」、「計測・半導体の技術シナジー追及」、「リカーリングビジネスの強化」の3項目であり、具体的な内容は記載の通りです。
- これらを支える事業基盤の強化として、下記5項目を定めております。

## 東京精密マテリアリティ（重要課題）

長期ビジョンの実現に向けて取り組むべきマテリアリティを特定し、新中期経営計画の戦略・施策へと展開



- 14ページは、この長期ビジョンの実現に向けて特定した新たなマテリアリティの要約です。
- 具体的には、6テーマ、23マテリアリティで構成されており、これらを達成することで、豊かな社会の実現に貢献してまいります。
- マテリアリティの詳細は、参考資料として、本資料に添付しています。

## 中期経営計画(2025-2027年度) 定量目標

2024年度実績に対し、約20%増収、50%増益の目標を設定

	2024年度 実績	中期経営計画期間 (2025-2027年度) 単年度	前提
売上高	<b>1,505億円</b> 半導体1,135億円 計測371億円	<b>1,850億円</b> 半導体1,400億円 計測450億円	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定量目標：単年目標として設定(市場ボラティリティを考慮)</li> <li>● 半導体：対象市場のCAGR前提 +5%をアウトパフォーム</li> <li>● 計測：非自動車(半導体, 航空, 宇宙など)の持続的な市況回復</li> <li>● 営業利益：売上増(高付加価値製品を含む) 原価低減の進展、リカーリングビジネス推進</li> <li>● ROE：純利益の積み増し</li> <li>● リスクファクター： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 民生アプリケーション需要の不確実性</li> <li>● 地政学リスク(中国の装置需要・競合等)</li> <li>● 工作機械受注の鈍化</li> </ul> </li> </ul>
営業利益	<b>297億円</b> 半導体243億円 計測54億円	<b>450億円</b>	
営業利益率	<b>20%</b> 半導体21% 計測15%	<b>24%</b>	
ROE	<b>15%</b>	<b>15%</b>	

- 15ページは、中期経営計画の定量目標です。  
設定したKPIは、売上高、営業利益、営業利益率、ROEで  
前回の計画から変更はございません。
- 具体的には、売上高が、2024年度実績比で約20%増の1,850億円、  
内訳は半導体が1,400億円、計測が450億円、  
営業利益が2024年度実績比で約50%増の450億円、営業利益率で24%、  
ROEは、前回計画同様15%としています。
- この前提ですが、まず半導体市場のボラティリティがございますので、  
特定年度の目標ではなく、3か年のいずれかの単年度目標として  
設定しています。
- また市場前提は、半導体では当社の製品市場の年平均成長率の想定を5%、  
当社は自助努力でアウトパフォームすること、  
計測では、対象市場の持続的な回復を想定します。
- 利益面では、高付加価値製品の販売拡大、原価低減の進展に加え、  
消耗品販売などのリカーリングビジネスを強化する前提です。  
これらをもとに営業利益率を高め、純利益を積み増すことで、  
ROEの水準の維持を狙います。

## キャッシュアロケーション

研究開発・設備投資・株主還元のバランスをとる

### 研究開発投資

開発強化、3年累計で350～400億円を想定

戦略製品開発、要素技術開発、計測と半導体のシナジー技術開発  
他社との共同研究開発の推進等

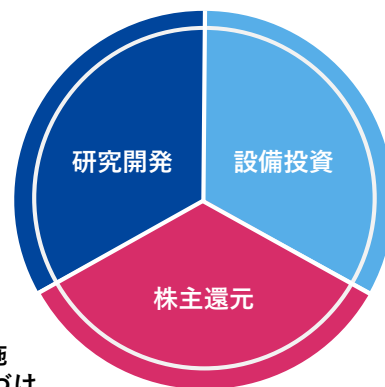
### 設備投資

将来を見据え、3年累計で累計300～400億円<sup>(\*)</sup>を想定

- 成長投資：名古屋工場、八王子新工場(2025年度用地取得)、  
韓国デモセンター新設、二次電池評価機能拡張等
- 事業基盤強化：IT強化、業務効率化、ESG関連投資

### 株主還元

配当による利益配分を基本に、連結配当性向40%を目安として実施  
自己株式取得は 剰余金配当を補完する機動的な利益還元策と位置づけ



(\*) 工事進捗により変動

- 16ページは定量目標を踏まえたキャッシュアロケーションの説明です。
- 研究開発投資は、売上高の10%以内を目安に、3年間累計で350億から400億円を投じ、戦略製品や要素技術の開発、半導体と計測のシナジー技術の開発を行うほか、他社との共同研究開発も推進します。
- 設備投資は、成長投資、事業基盤の強化の両面を実行します。成長投資に関しては、今年度、新たに東京都八王子市内で新工場を建設するための用地取得を行います。このほか、名古屋工場、韓国デモセンターを建設するなど、3年間累計で300億から400億円の投資を行う予定です。
- また、これらを実現するために、適切な現預金水準を維持する計画です。
- 株主還元については、配当による利益配分を基本として、配当性向40%を目安として実施する方針を維持します。また自己株式の取得については、配当を補完する機動的な利益還元策との位置づけを維持します。



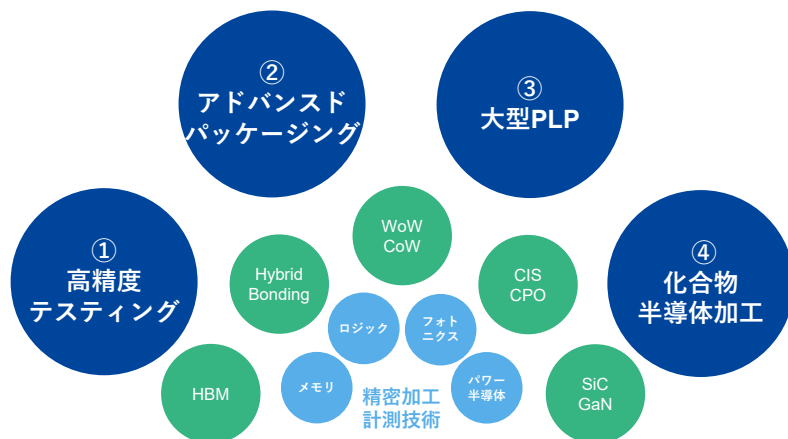
## アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- **中期経営計画(2025-2027年度) セグメント別事業機会**
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

- 次に、セグメント別の事業機会に関して説明します。

## セグメント別事業機会：半導体

テスト・加工領域の技術進化は著しい  
最先端の技術要求に応える製品の提供を続け、高付加価値を提供する



(注) CPO: Co-packaged Optics, WoW : Wafer on Wafer, CoW : Chip on Wafer, HBM: High Bandwidth Memory

### ① 高精度テストティング

- テスト時の高精度温度制御対応

### ② アドバンスドパッケージング

- 高品質ダイシング
- 研削工程増加・ハイエンドグラインダ要求
- チップ員数増によるテスト要求拡大
- 高精度エッジトリミング

### ③ 大型PLP

- 大型基板研削・切断
- PLPダイレクトプロービング

### ④ 化合物半導体加工

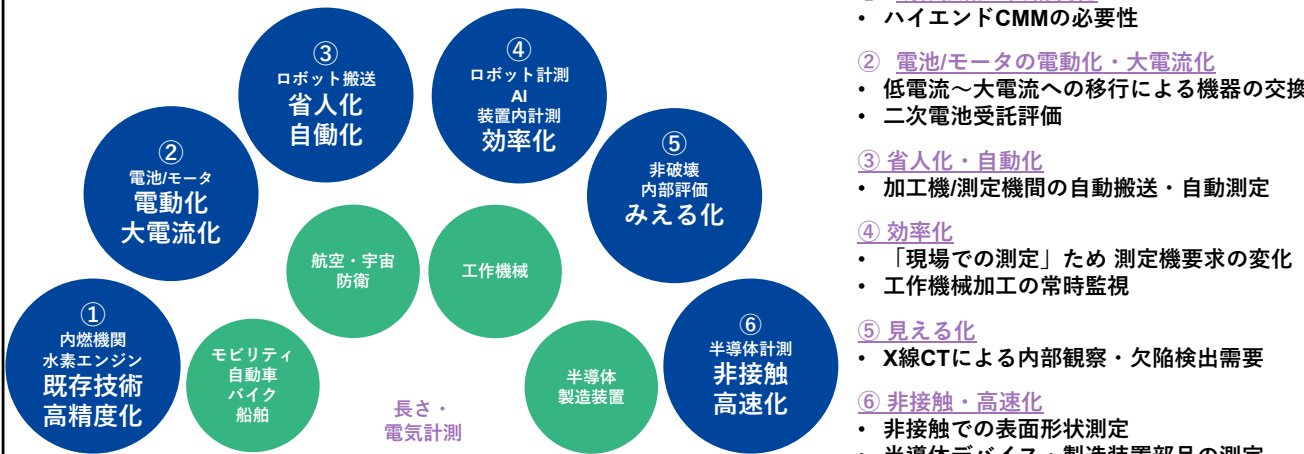
- ノンシリコン基板の研削

- 18ページは、半導体の事業機会の説明です。
- この図は中心に当社のコア技術を置き、そこから順に半導体デバイスの種類、特定の技術トレンド、そして当社の事業機会を配置しております。
- この図が示す通り、当社の事業機会は、高精度なテストティング要求、すなわちプローバの高付加価値化、アドバンスドパッケージング、大型PLP、化合物半導体など加工装置の高機能化につながるものです。
- いずれも、当社当社のコア技術である精密加工技術と、精密計測技術を駆使することで、事業機会を獲得することは可能と考えております。
- また、中長期的な目線では、新興国の競合メーカーの台頭というリスクが存在します。当社は、コア技術を基に、付加価値の高い後工程装置を提供することで、業容を拡大させる計画です。
- なお、現時点では、中期経営計画における売上構成比は大きく変化せず、検査装置、プローバが6割程度、加工装置が4割程度との前提を置いています。

## セグメント別事業機会：計測機器

測定ニーズが今まで以上に広がりを見せている

当社は汎用計測・自動計測・充放電試験システムのソリューションを拡大し、様々な計測ニーズに応え 業容を拡大する



(注) CMM: Coordinate Measuring Machine, (3次元)座標測定機、CT: Computed Tomography, コンピュータ断層撮影

- 19ページは、計測の事業機会の説明です。
- 前回の中期計画策定時は、内燃機関自動車向け需要が過半だったことや、業界ごとの成長エリア、成熟エリアが比較的明確でしたので、これらに合わせた戦略を策定しておりました。
- しかし、現在は、内燃機関の構成比は 4割程度まで下がったことや、測定ニーズが多岐にわたっていることなどから、製品や業界を区分せずに、当社がソリューションを拡大し、様々な計測ニーズに応じてゆく戦略をとる所存です。
- 当社の汎用計測製品・自動計測製品・充放電試験システムに加え、先ごろ内製化を開始したX線CTシステムなどによるソリューションを拡大し、様々なニーズに応え、業容を拡大する所存です。

## アジェンダ

- 前中期経営計画 振り返り
- パーパス・長期ビジョン
- 中期経営計画(2025-2027年度) 位置づけ・基本方針・定量目標
- 中期経営計画(2025-2027年度) 事業別戦略
- 中期経営計画(2025-2027年度) サステナビリティマネジメント

- 最後に、サステナビリティマネジメントについて説明いたします。

## 事業を支える基盤

“事業の発展を下支えする要素として重要視するもの”への取り組みを深める

要素技術開発の強化促進	<ul style="list-style-type: none"><li>● 事業部門間の技術交流によりイノベーションを促進</li><li>● 産官学連携の深化を通じた要素技術開発力の高度化</li><li>● 次世代技術の開拓</li></ul>
セグメント横断的な事業戦略組織	<ul style="list-style-type: none"><li>● 計測機器の半導体製造装置への搭載推進</li><li>● 技術融合による「当社独自の付加価値」、「差別化」の追求</li><li>● 全社的組織により新事業立案の推進</li></ul>
新たなチャレンジを促す環境	<ul style="list-style-type: none"><li>● 技術スキルセットの明確化、新技術習得へのモチベーション向上</li><li>● イノベティブなアイデアを養う教育の実施</li><li>● 若手社員がチャレンジできる場の創出</li></ul>
ITを活用した生産性向上	<ul style="list-style-type: none"><li>● ITを活用した業務の高度化・効率化の推進</li><li>● 生産システム高度化による生産性向上</li><li>● グローバルITインフラ共通化による情報共有推進</li></ul>

- これまでの説明である通り、当社は、今後の成長に向けて、積極的な活動を進めてまいります。
- そのうえで、下支えとなる要素として重要視している、21ページに示す内容についても積極的に進めてまいります。
- 特に、上段の、要素技術の開発については、製品開発とは別に行うべきもとと考えており、かつ、今後の差別化のために重要と考えております。
- また、新たなチャレンジを促す環境や、ITを活用した効率化も進めます。

## サステナビリティマネジメントの深化

事業の発展と不可分なESG経営を実践してゆく

<p><b>E</b> カーボンニュートラルに向けた企業活動の推進</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自社製品・サービスの提供を通じた環境負荷の低減</li><li>● 事業活動におけるGHG排出量の削減</li><li>● サステイナブル調達活動の推進</li></ul>
<p><b>S</b> 人を活かし 社会からの信頼を高める 企業姿勢の強化</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 従業員が心身の健康を保ち、能力を最大限に発揮できる職場環境の構築</li><li>● 従業員エンゲージメントの向上による、仕事意欲向上と組織一体感の強化</li><li>● 高品質な製品・サービスの提供による顧客満足度の向上</li></ul>
<p><b>G</b> 公正な企業活動の 基盤となる ガバナンスの強化</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● グループ全体での高い企業倫理・遵法精神の育成</li><li>● 適時・適切な情報開示の推進</li><li>● リスクマネジメントの強化</li></ul>

- 22ページは、ESGに係る活動計画の要約です。
- 先ほど説明した内容と重複するものもありますが、事業の発展と不可分なESG経営を実施してゆくことも重要です。記載のような取り組みを進め、より持続的な成長を実現するような会社になりたいと考えています。
- 以上が、2025年度から2027年度までの中期経営計画の説明です。ご清聴 ありがとうございました。

## 質疑応答 / Q&A

## (ご参考) 東京精密 マテリアリティ

テーマ (合計 6テーマ)	マテリアリティ (合計 23マテリアリティ)
豊かな社会の実現に貢献	社会課題を解決する製品の創出と提供
	未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献
	精密測定を通じたモノづくりのイノベーションへの貢献
持続可能な社会づくりに貢献する 事業活動の推進	バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減
	地球環境に貢献する製品の創出と提供
	環境保全と資源管理の最適化
	サーキュラー・エコノミーの実現
	環境マネジメントシステムの高度化
ステークホルダーの信用・信頼に応える 企業姿勢の維持・強化	バリューチェーンにおけるサステナビリティの推進
	製品品質と安定供給の確保及びカスタマーサポートの充実
	ステークホルダーエンゲージメントの推進
多様な人々が前向きに活々と働ける 職場環境の醸成	多様性・公平性・包摂性 (DE&I) の推進
	心身ともに健康で安全に働ける職場づくり
	従業員エンゲージメントの向上
公正な企業活動の基盤となるガバナンスの強化	コーポレート・ガバナンスの強化
	コンプライアンスの強化
	リスクマネジメントの推進
事業基盤の強化	人財育成の推進
	研究開発力の強化
	知的財産の管理と活用
	DXの推進
	変革を支える企業風土の醸成
	持続可能な安定経営の実現